

2023年3月期 決算説明会

2023年5月18日

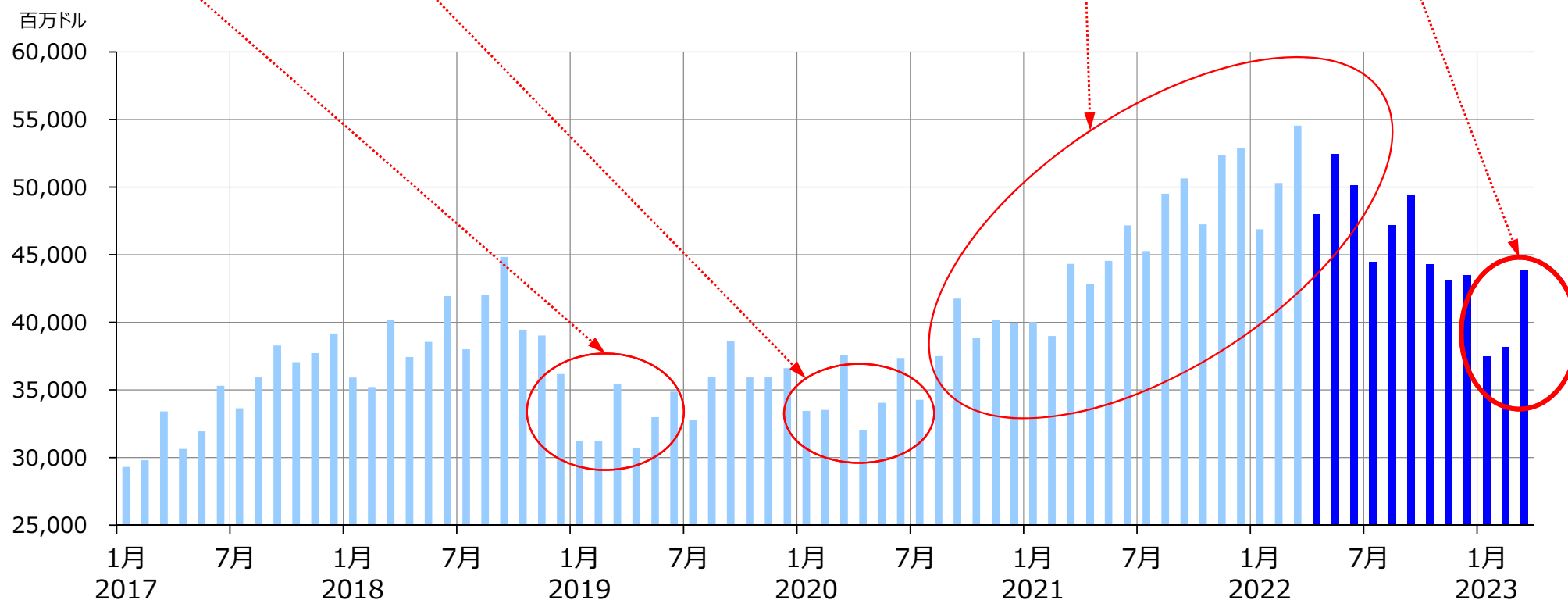
株式会社フジミインコーポレーテッド

市場概況

世界半導体市場動向（月次 実績 ※2023年3月まで）

出所：WSTS（2023/5）

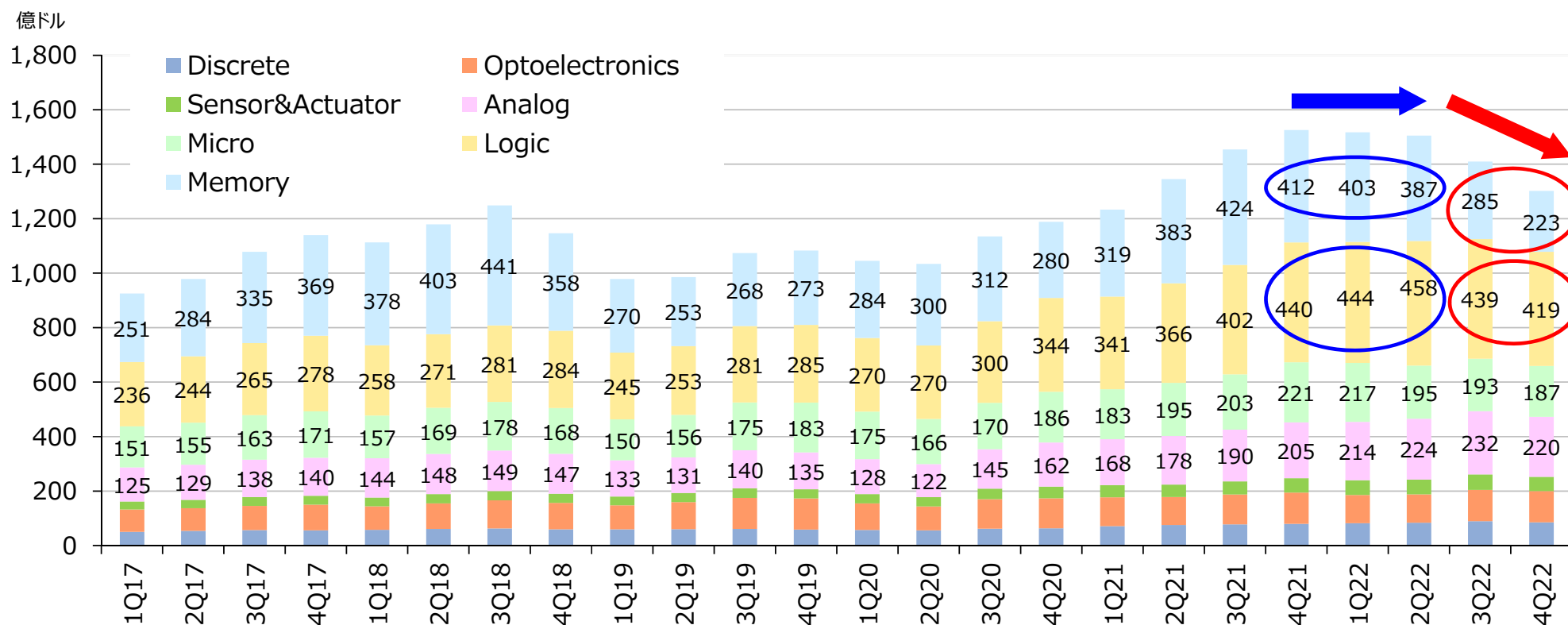
- 2019年、メモリアルの反動で1月から7月まで半年ほど低迷した後、北米、中国を中心に回復
- 2020年、新型コロナの影響で1月より再び下降 同年8月以降上昇に転じ、強い半導体需要が2022年6月まで継続
- 2022年、生産及び在庫の調整が見られ7月以降減速、23年1月には2年半前（20年8月）の水準を割り込むまで下落、3月の上昇は周期的なものと思料



世界半導体市場動向（四半期 実績） 用途別

出所：WSTS

- 21年10-12月期から22年4-6月期まで半導体市場は過去最高水準で推移
- 22年7-9月期からは調整局面に メモリ(QoQ -26%, YoY -33%) □ジック(QoQ -4%, YoY +9%)
- 22年10-12月期も調整局面が継続 メモリ(QoQ -22%, YoY -46%) □ジック(QoQ -5%, YoY -5%)

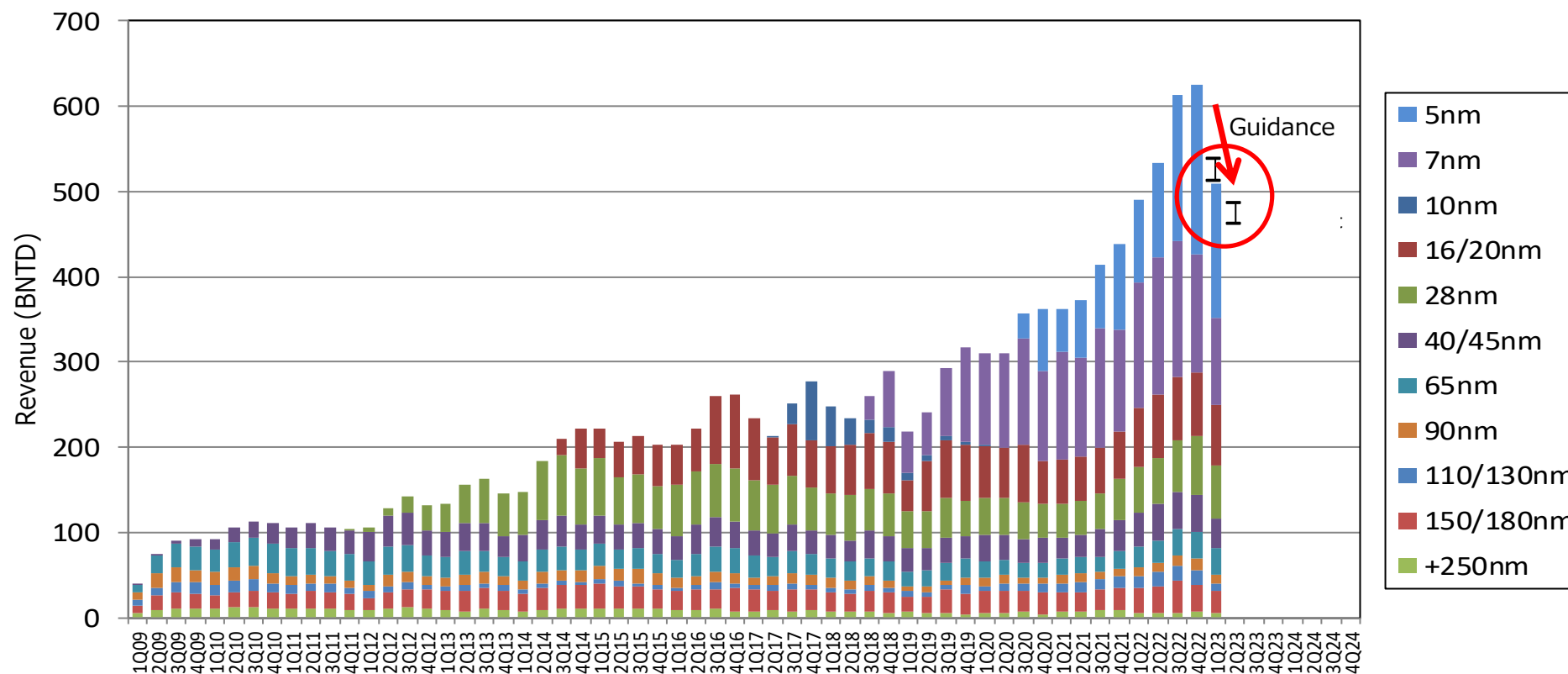


《暦年ベース》

台湾セミコンダクター（TSMC）売上高（2023年1-3月期）

出所：TSMC公開情報よりフジミ作成

- 23年1Q（1-3月期）の売上高はQoQ -19%
- 23年2Q（4-6月期）の売上高見通しはQoQ -7%（ガイダンスベース）
- 設備投資は減速（22年 363億米ドル → 23年 340億米ドル）



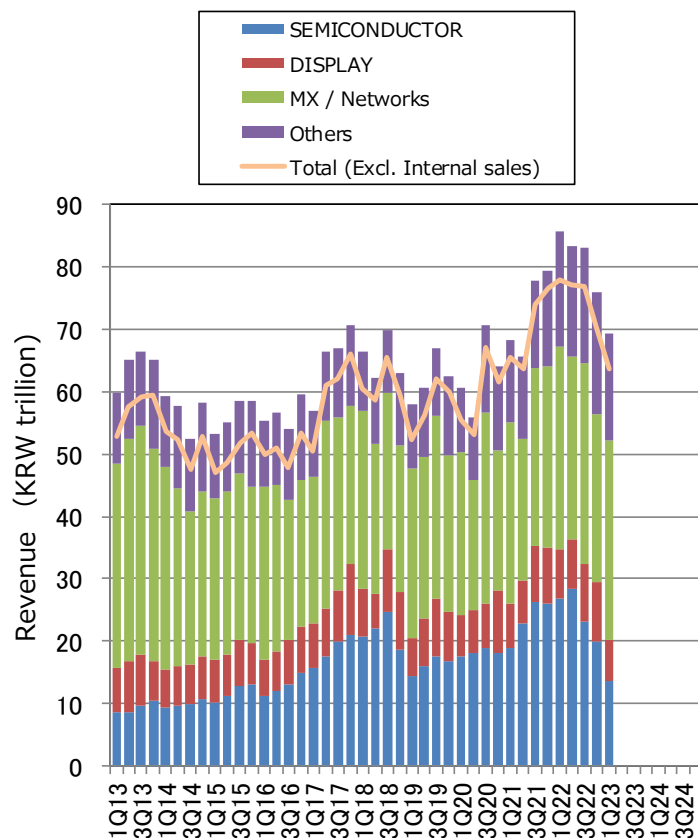
《暦年ベース》

サムスン電子 売上高 (2023年1-3月期)

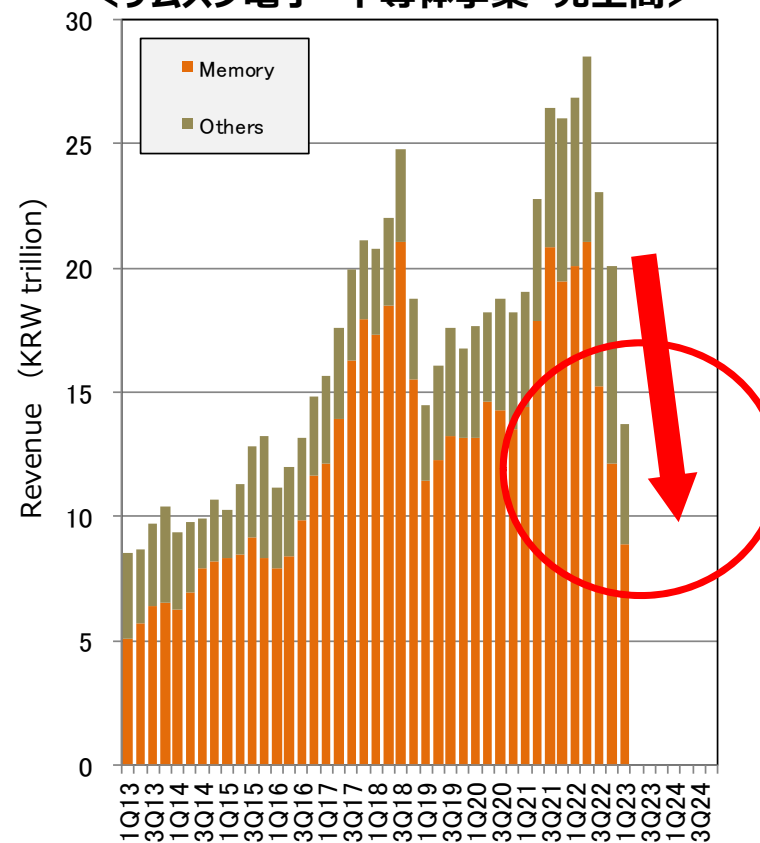
出所：サムスン電子公開情報よりフジミ作成

- 半導体事業は、メモリの減速により、22年4Q（10-12月期）の売上高はQoQ -13%
- 23年1Q（1-3月期）の売上高は、メモリに加えてロジックも減速し、QoQ -32%

<サムスン電子 全社 売上高>



<サムスン電子 半導体事業 売上高>

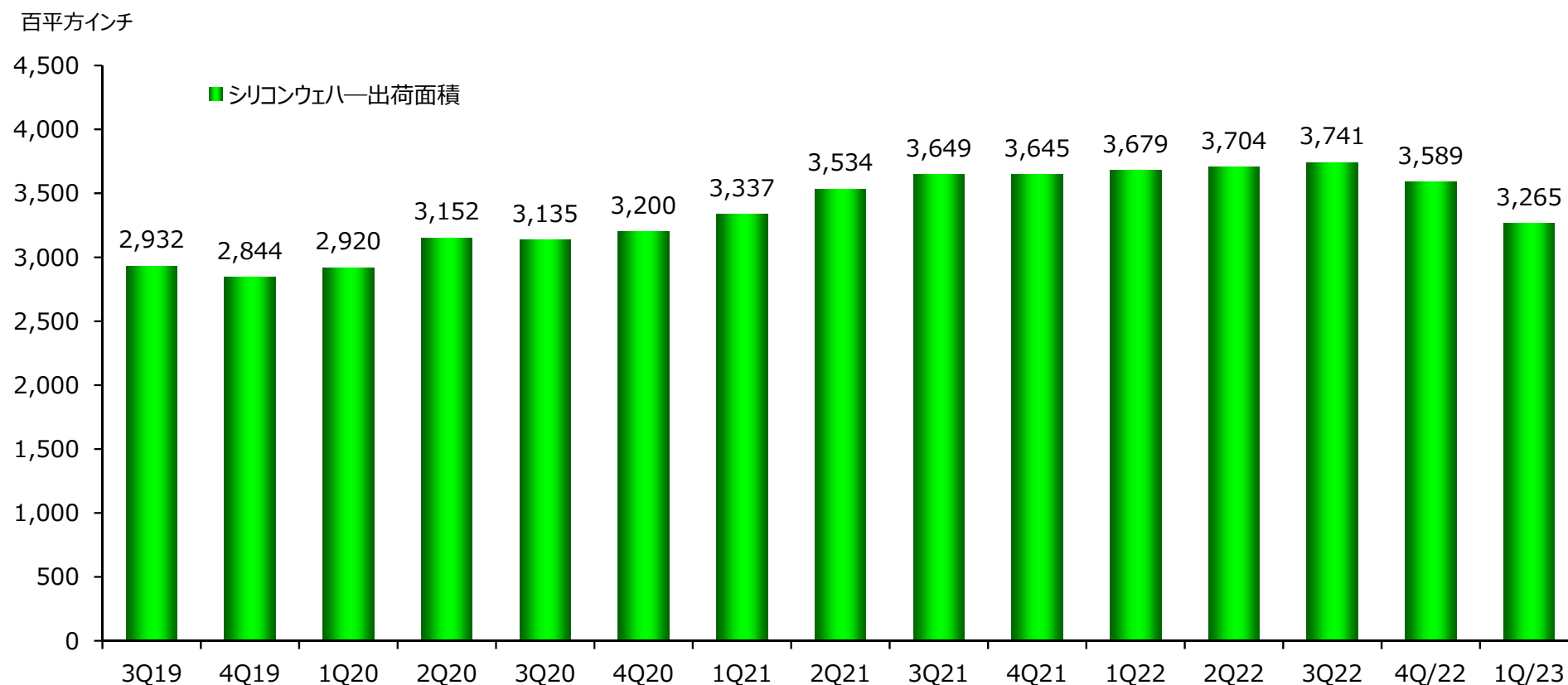


《暦年ベース》

シリコンウェハー出荷面積 実績 (四半期)

出所：SEMI (2023/5/2)

•半導体市場の調整が続く中、小口径ウェハーで調整あり、23年1Qは QoQ -9% YoY -11%

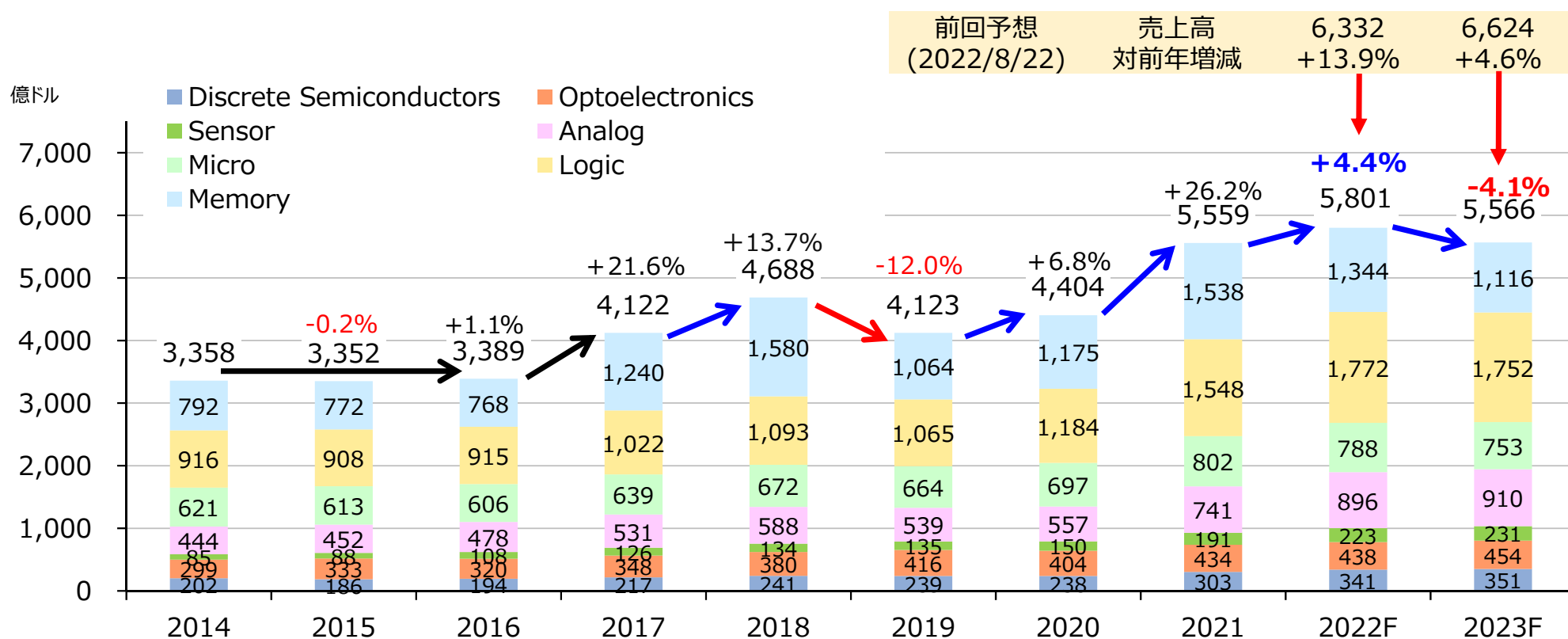


《暦年ベース》

世界半導体市場動向（年次 WSTS予測） 用途別

出所：WSTS（2022/11/29）

- 2023年の市場予想は、PC・スマホ市場の低迷により、4.6%から**-4.1%**へマイナス成長に下方修正
（Gartnerによる2023年の市場予想は、**-11%** 2023年4月26日付）



《暦年ベース》

決算概要

決算概要 (通期実績)

単位：百万円

	22年3月期	23年3月期					
	通期実績	期初予想 ('22/5)	修正予想 ('22/11)	通期実績	前期比	期初予想比 ('22/5)	修正予想比 ('22/11)
売上高	51,731	58,000	62,200	58,394	+12.9%	+0.7%	△6.1%
営業利益 率	12,059 23.3%	13,500 23.3%	14,800 23.8%	13,243 22.7%	+9.8% -	△1.9% -	△10.5% -
経常利益 率	12,490 24.1%	13,600 23.4%	15,300 24.6%	13,595 23.3%	+8.8% -	△0.0% -	△11.1% -
当期純利益 率	9,156 17.7%	10,000 17.2%	11,500 18.5%	10,594 18.1%	+15.7% -	+5.9% -	△7.9% -

(前期比) 上期の堅調な半導体需要に加え、原材料高騰に伴う製品値上げや為替の影響もあり、増収増益
 (期初予想比) 通期実績は期初予想値と概ね一致
 (修正予想比) 下期に入り、半導体デバイスの生産及び在庫の調整が加速したことにより、未達

決算概要 (半期実績)

単位：百万円

	22年3月期		23年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	前年同期比	前年下期比	下期実績	前年同期比	同年上期比
売上高	25,291	26,439	31,097	+23.0%	+17.6%	27,296	+3.2%	△12.2%
営業利益	6,158	5,900	7,819	+27.0%	+32.5%	5,423	△8.1%	△30.6%
率	24.4%	22.3%	25.1%	-	-	19.9%	-	-
経常利益	6,357	6,133	8,293	+30.5%	+35.2%	5,301	△13.6%	△36.1%
率	25.1%	23.2%	26.7%	-	-	19.4%	-	-
四半期純利益	4,803	4,353	6,155	+28.1%	+41.4%	4,439	+2.0%	△27.9%
率	19.0%	16.5%	19.8%	-	-	16.3%	-	-

上期 堅調な半導体需要により大幅増収増益

下期 売上高：半導体デバイスの生産及び在庫の調整が続き、前年同期比で微増も同年上期比で減少

利益：前年同期比 売上微増も原材料高騰や経費増により減益

同年上期比 売上高減少とそれに伴う製品ミックスの変化により大幅減益

業績予想（通期）

単位：百万円

	22年3月期	23年3月期	24年3月期	
	通期実績	通期実績	通期予想	前年比
売上高	51,731	58,394	58,500	+0.2%
営業利益	12,059	13,243	12,500	△5.6%
率	23.3%	22.7%	21.4%	-
経常利益	12,490	13,595	12,700	△6.6%
率	24.1%	23.3%	21.7%	-
当期純利益	9,156	10,594	9,600	△9.4%
率	17.7%	18.1%	16.4%	-

・売上横ばい、減益予想

・想定為替レート：130円／ドル（前年実績：135円／ドル）

・売上高：上期には半導体デバイスの生産及び在庫の調整が続くも、下期の需要回復を想定

・利益：売上高は前期同程度となるも、原材料価格高騰、減価償却費増により、減益を想定

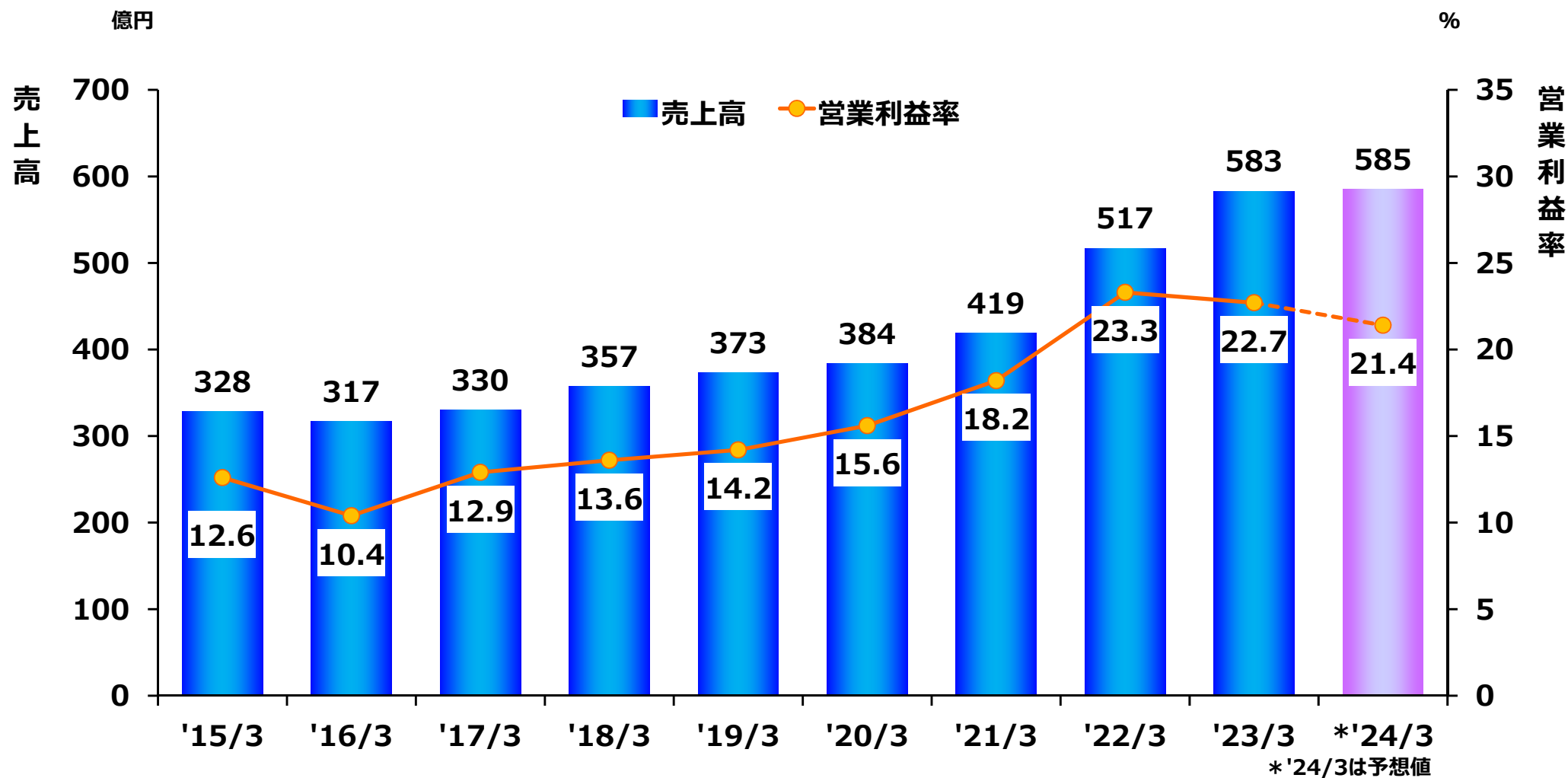
業績予想（半期）

単位：百万円

	23年3月期		24年3月期					
	上期実績	下期実績	上期予想	前年同期比	前年下期比	下期予想	前年同期比	同年上期比
売上高	31,097	27,296	27,500	△11.6%	+0.7%	31,000	+13.6%	+12.7%
営業利益	7,819	5,423	5,400	△30.9%	△0.4%	7,100	+30.9%	+31.5%
率	25.1%	19.9%	19.6%	-	-	22.9%	-	-
経常利益	8,293	5,301	5,500	△33.7%	+3.7%	7,200	+35.8%	+30.9%
率	26.7%	19.4%	20.0%	-	-	23.2%	-	-
四半期純利益	6,155	4,439	4,100	△33.4%	△7.6%	5,500	+23.9%	+34.1%
率	19.8%	16.3%	14.9%	-	-	17.7%	-	-

・上期には半導体デバイスの生産及び在庫の調整が続くも、下期の需要回復を想定し、下期の売上増加を見込む

業績推移 (今期予想含む)



用途別売上高

用途別売上高（通期実績）

単位：百万円

		22年3月期	23年3月期					
		通期実績	期初予想 ('22/5)	修正予想 ('22/11)	通期実績	前期比	期初予想比 ('22/5)	修正予想比 ('22/11)
シリコンウエハー	ラッピング	6,249	7,190	7,421	7,094	+13.5%	△1.3%	△4.4%
	ポリシング	12,149	14,100	14,144	13,730	+13.0%	△2.6%	△2.9%
	切断	266	260	233	248	△6.9%	△4.6%	+6.5%
	計	18,665	21,550	21,800	21,072	+12.9%	△2.2%	△3.3%
CMP		24,571	27,400	31,000	28,680	+16.7%	+4.7%	△7.5%
ディスク	アルミディスク	1,684	1,945	1,650	1,468	△12.8%	△24.5%	△11.0%
	ガラスディスク	41	55	50	37	△8.1%	△30.9%	△24.0%
	計	1,725	2,000	1,700	1,506	△12.7%	△24.7%	△11.4%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	4,408	4,730	5,000	4,603	+4.4%	△2.7%	△7.9%
	一般工業用(非研磨材)	2,192	2,200	2,600	2,428	+10.8%	+10.4%	△6.6%
	計	6,600	6,930	7,600	7,031	+6.5%	+1.5%	△7.5%
製品売上高		51,564	57,880	62,100	58,290	+13.0%	+0.7%	△6.1%
商品売上高		167	120	100	103	△38.1%	△13.7%	+3.5%
売上高 合計		51,731	58,000	62,200	58,394	+12.9%	+0.7%	△6.1%

用途別売上高（半期実績）

単位：百万円

単位：百万円		22年3月期		23年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	前年同期比	前年下期比	下期実績	前年同期比	同年上期比
シリコンウエハー	ラッピング	2,985	3,264	3,538	+18.5%	+8.4%	3,555	+8.9%	+0.5%
	ポリシング	6,007	6,142	7,013	+16.7%	+14.2%	6,717	+9.4%	△4.2%
	切断	136	129	109	△19.5%	△15.4%	138	+6.4%	+25.7%
	計	9,129	9,536	10,661	+16.8%	+11.8%	10,410	+9.2%	△2.4%
CMP		12,155	12,416	15,771	+29.8%	+27.0%	12,908	+4.0%	△18.2%
ディスク	アルミディスク	770	913	987	+28.1%	+8.1%	480	△47.4%	△51.3%
	ガラスディスク	19	21	14	△25.0%	△30.0%	23	+7.7%	+53.7%
	計	790	935	1,002	+26.8%	+7.2%	503	△46.1%	△49.7%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,140	2,268	2,338	+9.2%	+3.1%	2,264	△0.1%	△3.1%
	一般工業用(非研磨材)	968	1,223	1,252	+29.3%	+2.3%	1,176	△3.9%	△6.1%
	計	3,109	3,491	3,590	+15.5%	+2.8%	3,440	△1.4%	△4.2%
製品売上高		25,185	26,379	31,026	+23.2%	+17.6%	27,264	+3.4%	△12.1%
商品売上高		106	60	70	△33.8%	+17.0%	32	△45.8%	△53.6%
売上高 合計		25,291	26,439	31,097	+23.0%	+17.6%	27,296	+3.2%	△12.2%

用途別売上高 (通期予想)

*24年3月期より、フィルター材、3Dプリンター材料を研磨材から非研磨材に組替 (22年3月期、23年3月期においても組替後の実績を表示)

単位：百万円

		22年3月期	23年3月期	24年3月期	
		通期実績	通期実績	通期予想	前期比
シリコンウエハー	ラッピング	6,249	7,094	7,300	+2.9%
	ポリシング	12,149	13,730	14,000	+2.0%
	切断	266	248	200	△19.4%
	計	18,665	21,072	21,500	+2.0%
CMP		24,571	28,680	27,100	△5.5%
ディスク	アルミディスク	1,684	1,468	1,700	+15.8%
	ガラスディスク	41	37	0	△100.0%
	計	1,725	1,506	1,700	+12.8%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)*	4,238	4,430	5,400	+21.9%
	一般工業用(非研磨材)*	2,362	2,601	2,700	+3.8%
	計	6,600	7,031	8,100	+15.2%
製品売上高		51,564	58,290	58,400	+0.2%
商品売上高		167	103	100	△3.4%
売上高 合計		51,731	58,394	58,500	+0.2%

用途別売上高 (半期予想)

*24年3月期より、フィルター材、3Dプリンター材料を研磨材から非研磨材に組替 (23年3月期においても組替後の実績を表示)

単位：百万円

		23年3月期		24年3月期					
		上期実績	下期実績	上期予想	前年同期比	前年下期比	下期予想	前年同期比	同年上期比
シリコンウエハー	ラッピング	3,538	3,555	3,400	△3.9%	△4.4%	3,900	+9.7%	+14.7%
	ポリシング	7,013	6,717	6,500	△7.3%	△3.2%	7,500	+11.7%	+15.4%
	切断	109	138	100	△9.0%	△27.6%	100	△27.6%	0.0%
	計	10,661	10,410	10,000	△6.2%	△3.9%	11,500	+10.5%	+15.0%
CMP		15,771	12,908	12,900	△18.2%	△0.1%	14,200	+10.0%	+10.1%
ディスク	アルミディスク	987	480	700	△29.1%	+45.6%	1,000	+107.9%	+42.9%
	ガラスディスク	14	23	0	△100.0%	△100.0%	0	△100.0%	-
	計	1,002	503	700	△30.2%	+38.9%	1,000	+98.4%	+42.9%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)*	2,260	2,170	2,600	+15.0%	+19.8%	2,800	+29.0%	+7.7%
	一般工業用(非研磨材)*	1,330	1,271	1,250	△6.0%	△1.7%	1,450	+14.1%	+16.0%
	計	3,590	3,440	3,850	+7.2%	+11.9%	4,250	+23.5%	+10.4%
製品売上高		31,026	27,264	27,450	△11.5%	+0.7%	30,950	+13.5%	+12.8%
商品売上高		70	32	50	△29.3%	+52.5%	50	+52.5%	0.0%
売上高 合計		31,097	27,296	27,500	△11.6%	+0.7%	31,000	+13.6%	+12.7%

シリコンウェハ－売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

《通期》

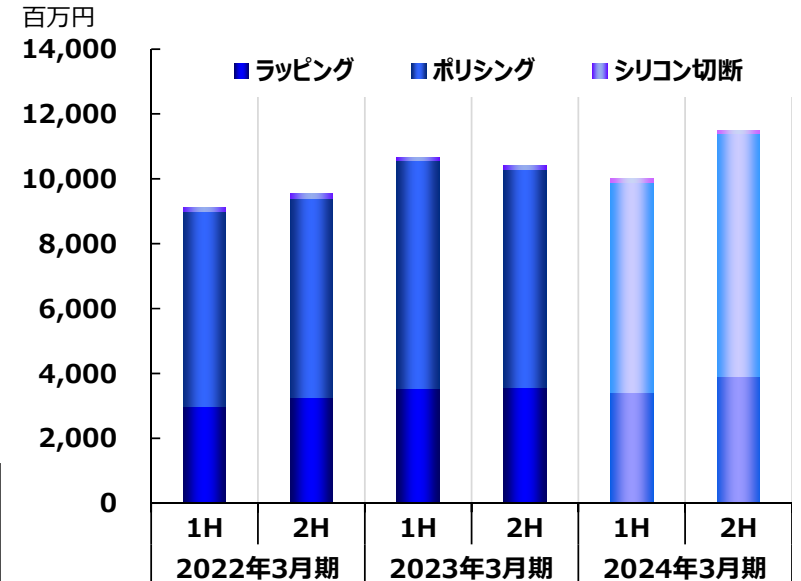
単位：百万円

		22年3月期	23年3月期		24年3月期	
			通期実績	通期実績	前年比	通期予想
シリコンウェハ－	ラッピング	6,249	7,094	+13.5%	7,300	+2.9%
	ポリシング	12,149	13,730	+13.0%	14,000	+2.0%
	切断	266	248	△6.9%	200	△19.4%
	計	18,665	21,072	+12.9%	21,500	+2.0%

《半期》

単位：百万円

		22年3月期		23年3月期		24年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
シリコンウェハ－	ラッピング	2,985	3,264	3,538	3,555	3,400	3,900
	ポリシング	6,007	6,142	7,013	6,717	6,500	7,500
	切断	136	129	109	138	100	100
	計	9,129	9,536	10,661	10,410	10,000	11,500



(23/3) 上期 堅調な半導体市場に伴うシリコンウェハ－の高稼働により増収
 下期 小口径ウェハ－の生産調整もあり、ポリシングは同年上期比で減収
 (24/3) 上期 半導体市場の調整局面が継続し、売上高は前年下期比で減少を予想
 下期 半導体市場の回復を想定し、売上高の増加を予想（上期比15%増）

* '24/3は予想値

CMP売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

「通期」

単位：百万円

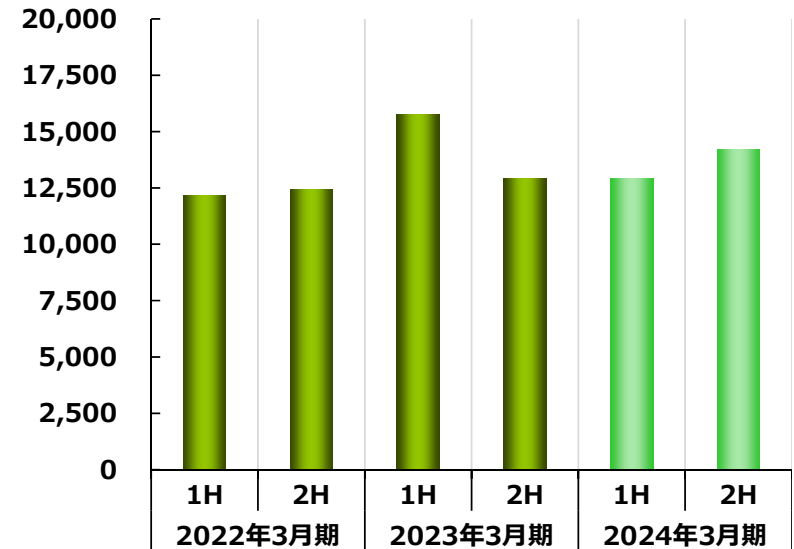
	22年3月期	23年3月期		24年3月期	
	通期実績	通期実績	前年比	通期予想	前年比
CMP	24,571	28,680	+16.7%	27,100	△5.5%

「半期」

単位：百万円

	22年3月期		23年3月期		24年3月期	
	上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
CMP	12,155	12,416	15,771	12,908	12,900	14,200

百万円



(23/3) 上期 ロジック、メモリともに好調な需要と為替の影響により大幅増収

下期 半導体市場の調整を受け同年上期比で大幅減収

(24/3) 上期 半導体市場の調整局面が継続し、売上高は前年下期比で微減を予想

下期 半導体市場の回復を想定し、売上高の増加を予想（上期比10%増）

* '24/3は予想値

ディスク売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

《通期》

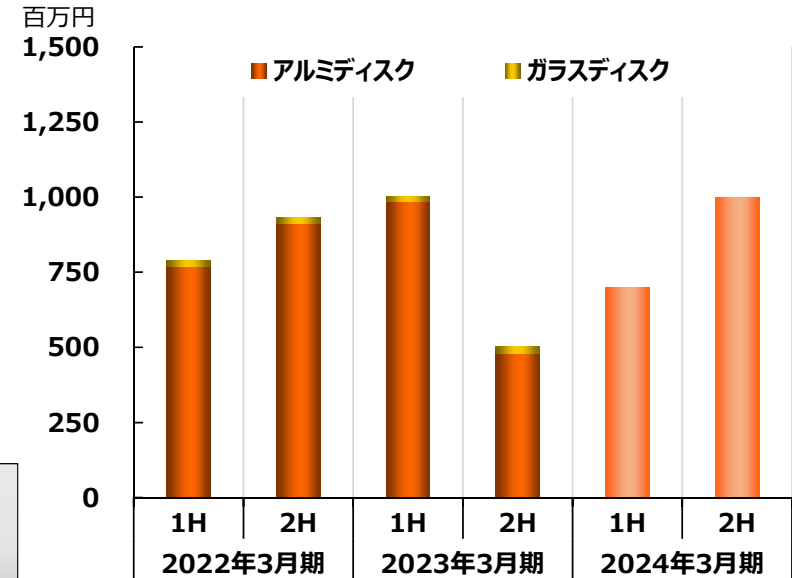
単位：百万円

		22年3月期	23年3月期		24年3月期	
			通期実績	通期実績	前年比	通期予想
ディスク	アルミディスク	1,684	1,468	△12.8%	1,700	+15.8%
	ガラスディスク	41	37	△8.1%	0	-
	計	1,725	1,506	△12.7%	1,700	+12.8%

《半期》

単位：百万円

		22年3月期		23年3月期		24年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
ディスク	アルミディスク	770	913	987	480	700	1,000
	ガラスディスク	19	21	14	23	0	0
	計	790	935	1,002	503	700	1,000



(23/3) 上期 顧客の稼働回復と為替の影響により増収

下期 第3四半期におけるHDD市場の急激な調整を受け大幅減収

(24/3) 上期 HDD市場の段階的な回復を見込み、前年下期比で増収を予想

下期 HDD市場の継続的な回復及びシェア奪回を見込み、増収を予想（上期比43%増）

* '24/3は予想値

機能材・溶射材売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

*24年3月期より、フィルター材、3Dプリンター材料を研磨材から非研磨材に組替（22年3月期、23年3月期においても組替後の実績を表示）

《通期》

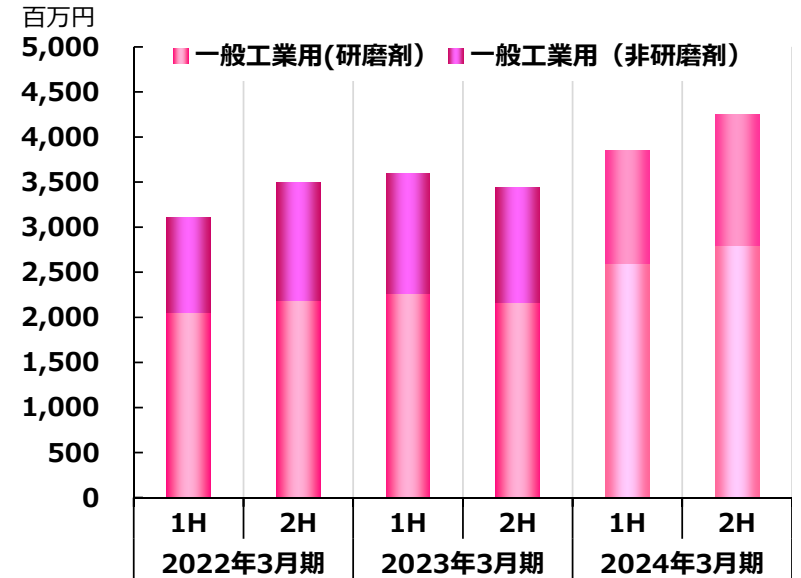
単位：百万円

		22年3月期	23年3月期		24年3月期	
		通期実績	通期実績	前年比	通期予想	前年比
機能材・溶射材	一般工業用（研磨材）*	4,238	4,430	+4.5%	5,400	+21.9%
	一般工業用（非研磨材）*	2,362	2,601	+10.1%	2,700	+3.8%
	計	6,600	7,031	+6.5%	8,100	+15.2%

《半期》

単位：百万円

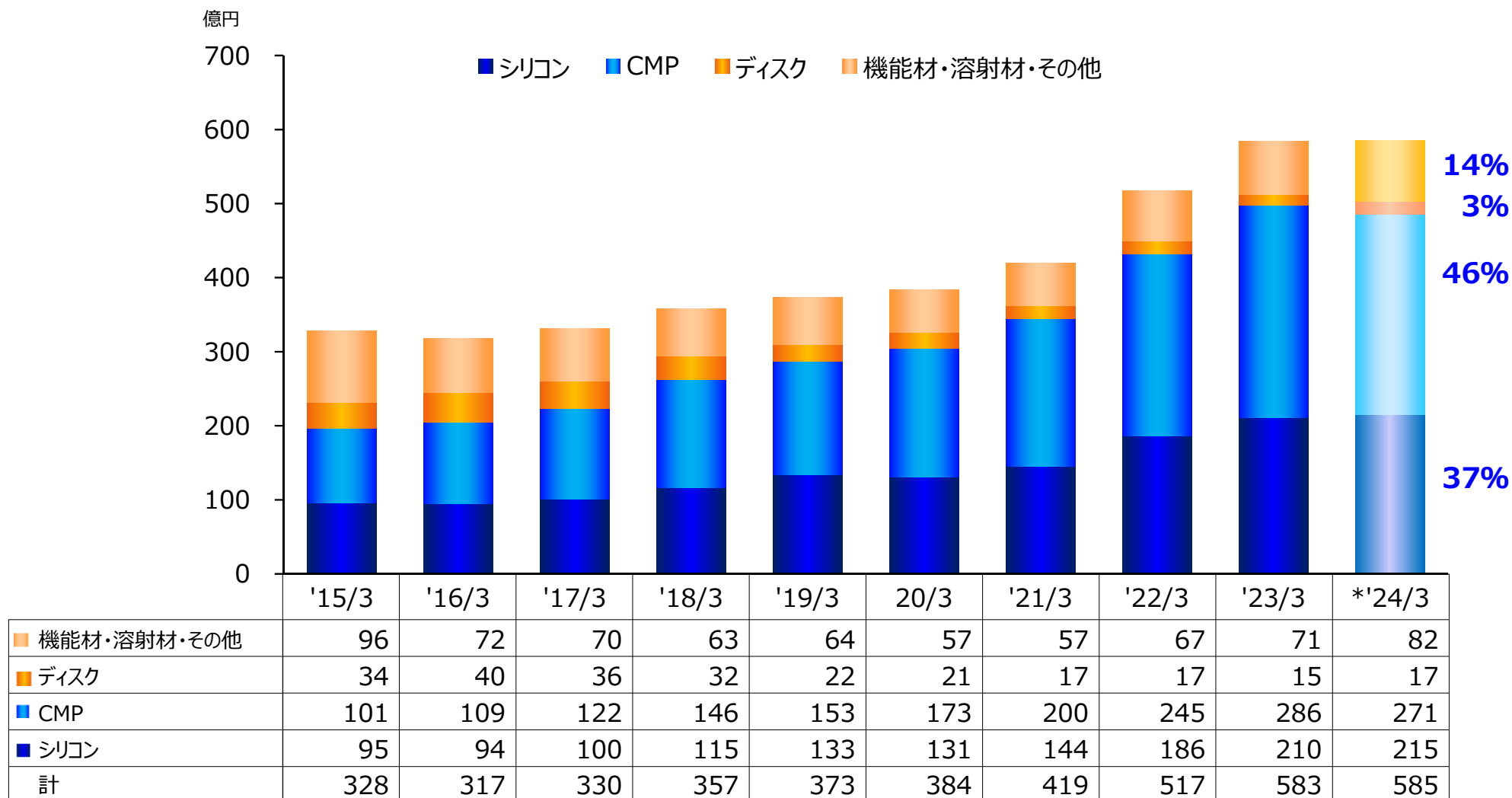
		22年3月期		23年3月期		24年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
機能材・溶射材	一般工業用（研磨材）*	2,054	2,184	2,260	2,170	2,600	2,800
	一般工業用（非研磨材）*	1,055	1,307	1,330	1,271	1,250	1,450
	計	3,109	3,491	3,590	3,440	3,850	4,250



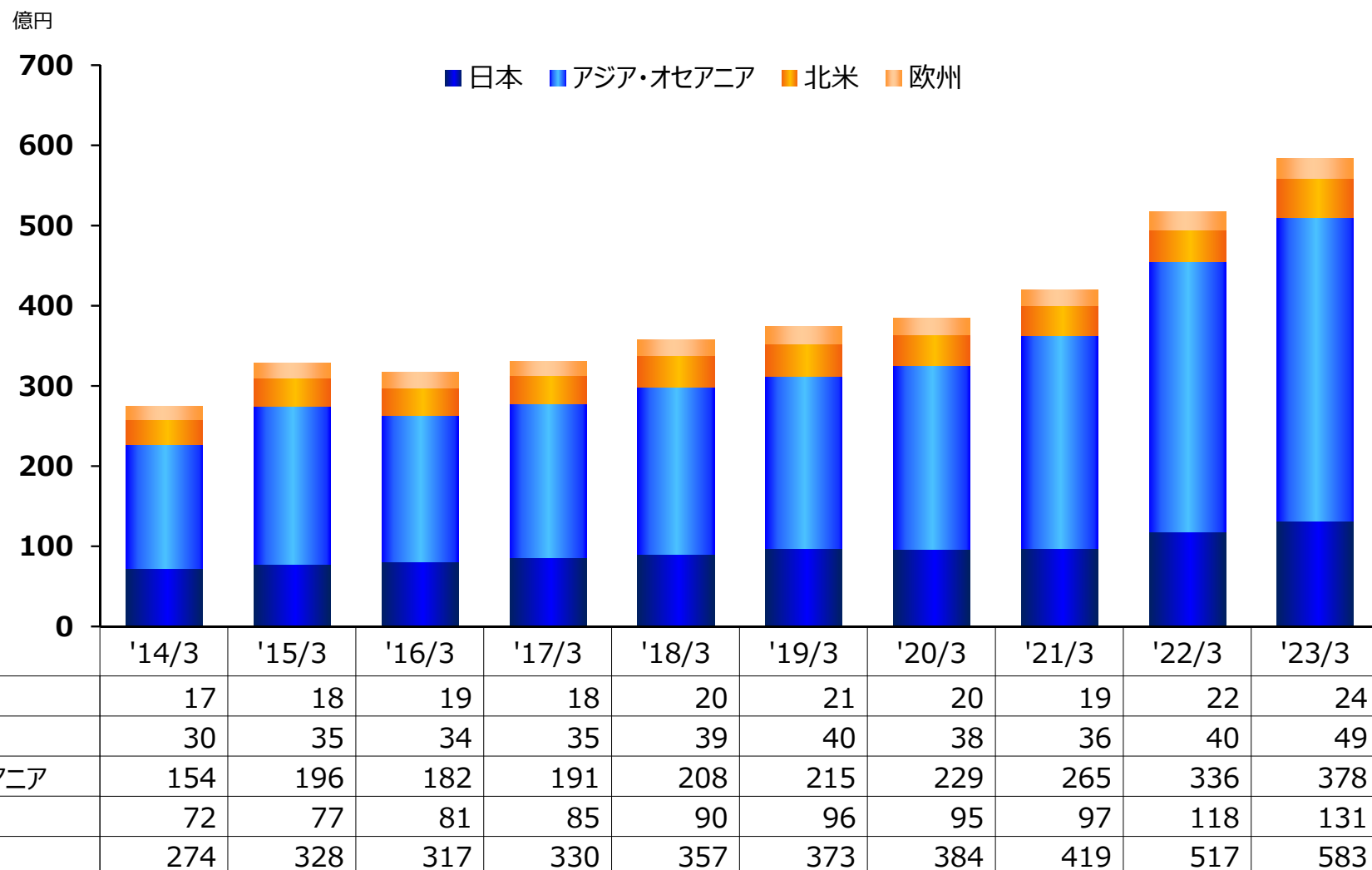
【研磨材】(23/3) 自動車及び産業機械向け需要の回復もあり増収
 (24/3) SiCウェハー向け研磨材で増収を予想（上期比8%増）
 【＃以外】(23/3) 半導体装置向け溶射材で増収
 (24/3) 触媒担体向け機能性材で微増収を予想（上期比16%増）

*'24/3は予想値

用途別売上高（通期）



地域別売上高（通期 仕向先別）



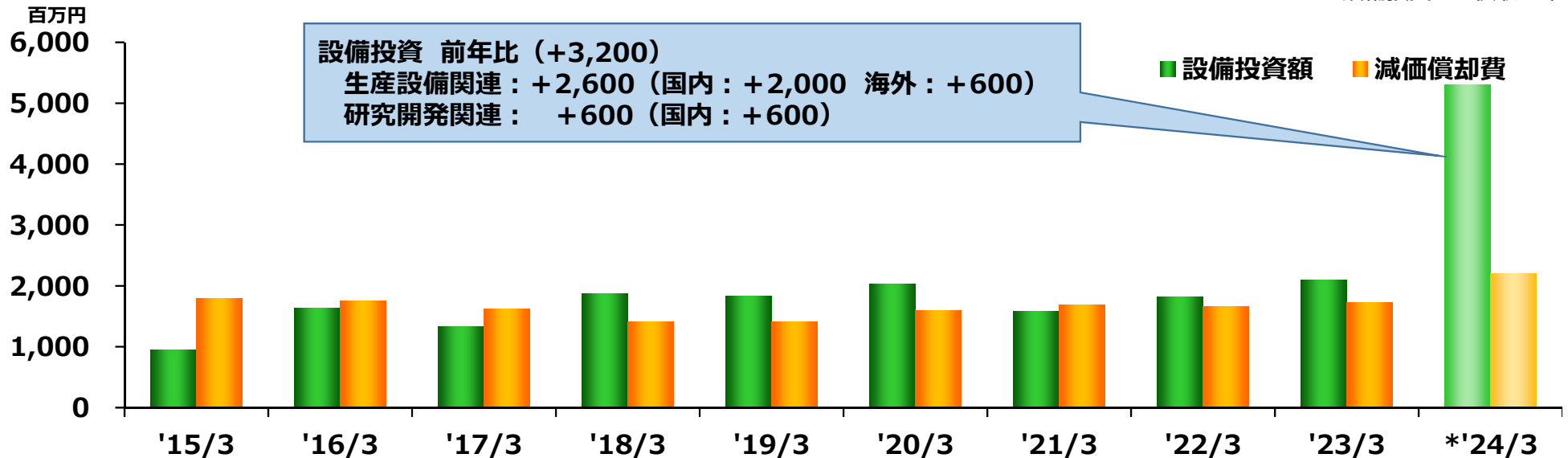
設備投資額 減価償却費 研究開発費

設備投資額・減価償却費（通期実績・通期計画）

単位：百万円

	22年3月期	23年3月期						24年3月期	
	通期実績	期初計画	修正計画	通期実績	前年比	期初計画比	修正計画比	通期計画	前年比
設備投資額	1,814	3,400	4,100	2,094	+15.5%	△38.4%	△48.9%	5,300	+153.0%
減価償却費	1,661	1,800	1,800	1,729	+4.1%	△3.9%	△3.9%	2,200	+27.2%

* 設備投資額は検収基準



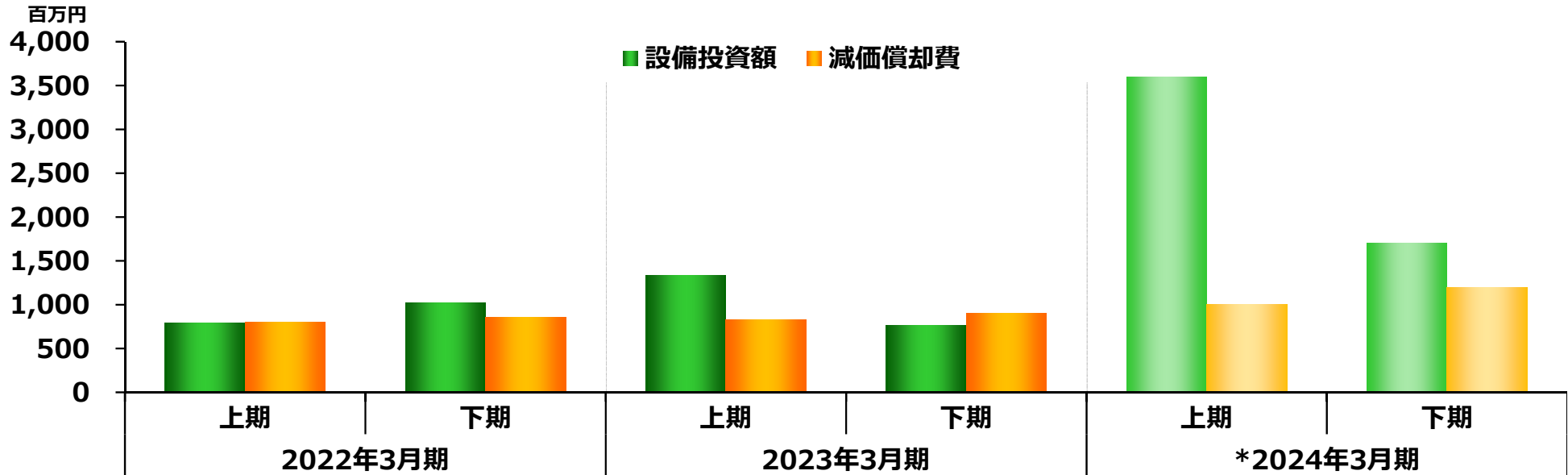
* '24/3は計画

設備投資額・減価償却費（半期実績・半期計画）

単位：百万円

	22年3月期		23年3月期				24年3月期					
	上期 実績	下期 実績	上期 実績	下期 実績			上期 計画			下期 計画		
					前年 同期比	同年 上期比		前年 同期比	前年 下期比		前年 同期比	同年 上期比
設備投資額	789	1,024	1,333	761	△25.7%	△42.9%	3,600	+170.0%	+372.6%	1,700	+123.2%	△52.8%
減価償却費	802	859	826	903	+5.1%	+9.3%	1,000	+21.0%	+10.7%	1,200	+32.8%	+20.0%

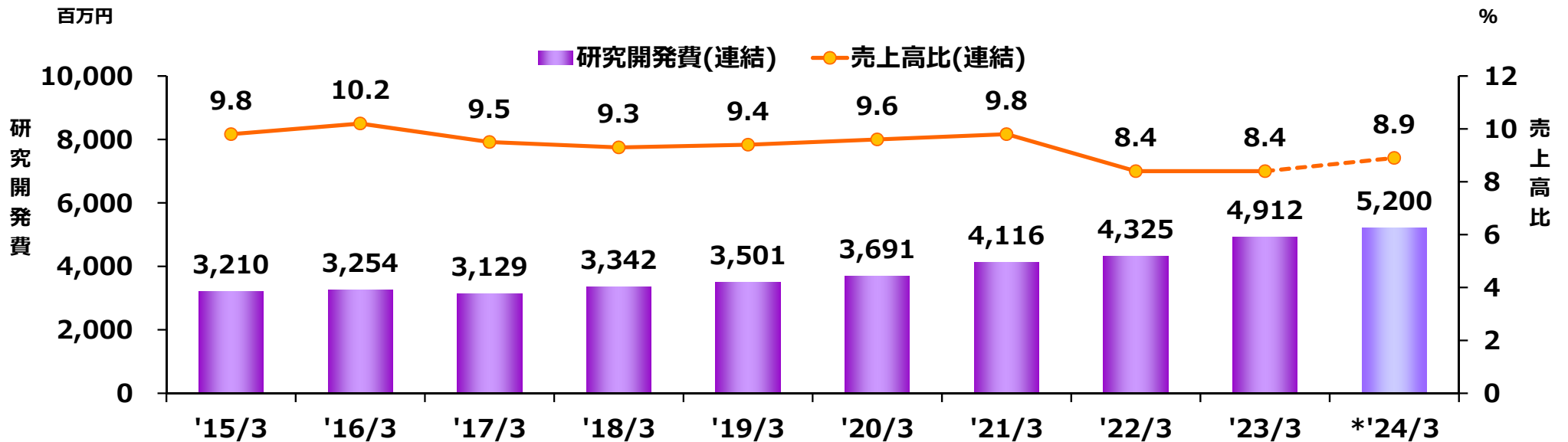
* 設備投資額は検収基準



研究開発費／売上高比（通期実績・通期計画）

単位：百万円

	22年3月期	23年3月期						24年3月期	
	通期実績	通期計画	修正計画	通期実績	前期比	期初計画比	修正計画比	通期計画	前年比
研究開発費	4,325	4,800	4,800	4,912	+13.6%	+2.3%	+2.3%	5,200	+5.9%



*'24/3は計画

損益分析

営業利益増減要因 22/3期実績→23/3期実績

売上高 517億円

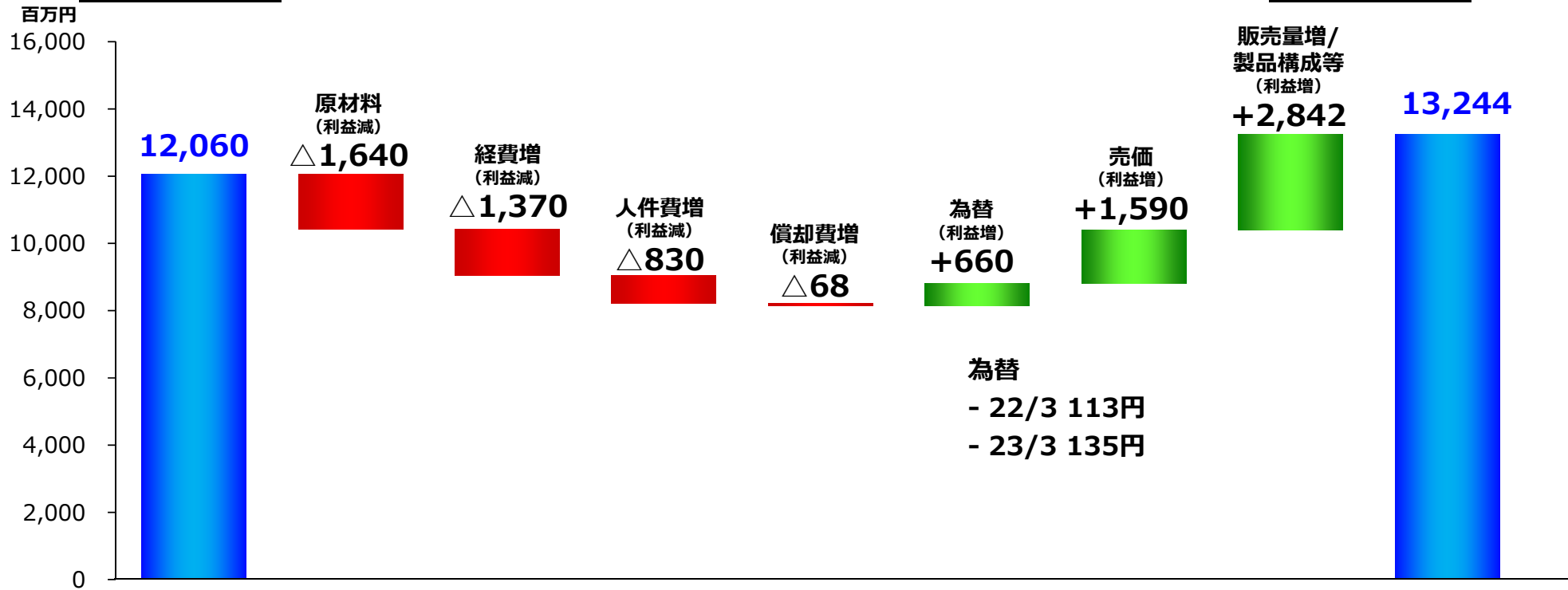
584億円

22/3期
実績

(売上増) +6,663

(利益増) +1,184

23/3期
実績



営業利益増減要因 23/3期実績→24/3期予想

売上高 584億円

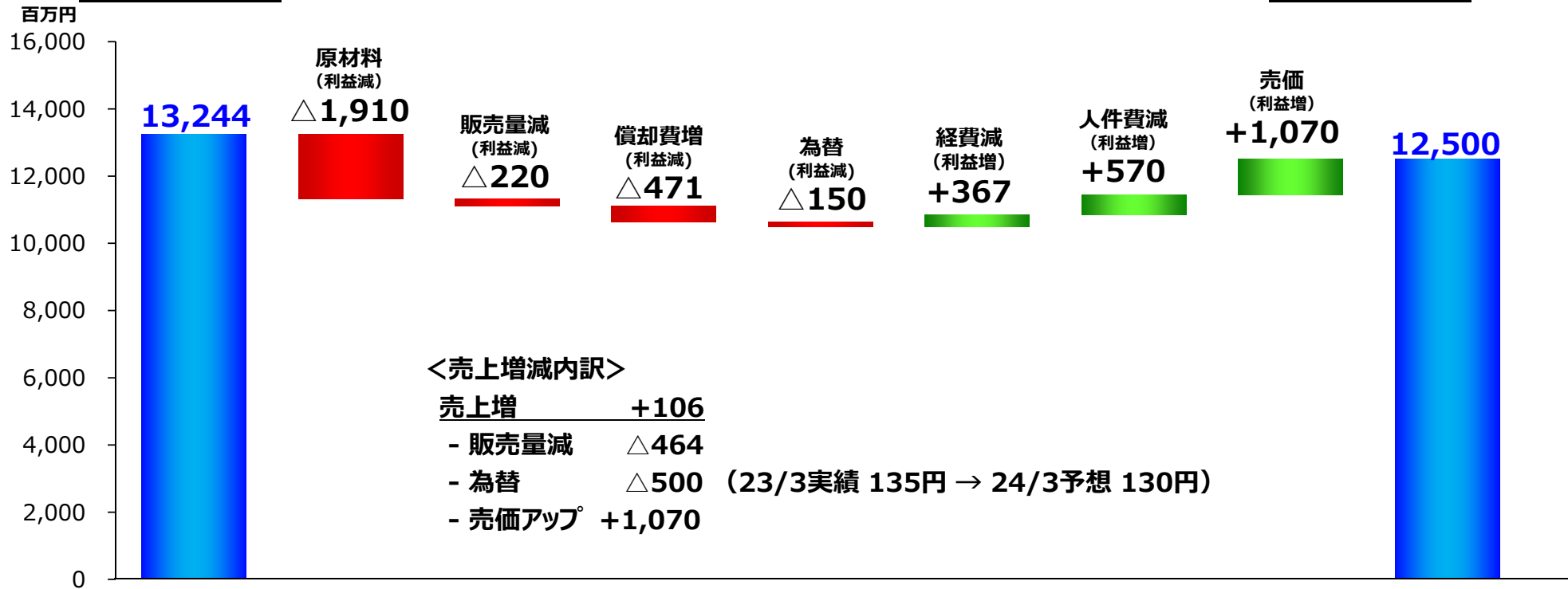
585億円

23/3期
実績

(売上増) +106

(利益減) △744

24/3期
予想



株主還元

積極的な株主還元と安定配当の継続

■ 利益配分に関する基本方針

1. 連結配当性向 50%以上 ➡ **55%**以上 (2024年3月期より)
2. 安定配当の継続

*DOEの配当指標への追加については検討中

■ 1株当たり配当金

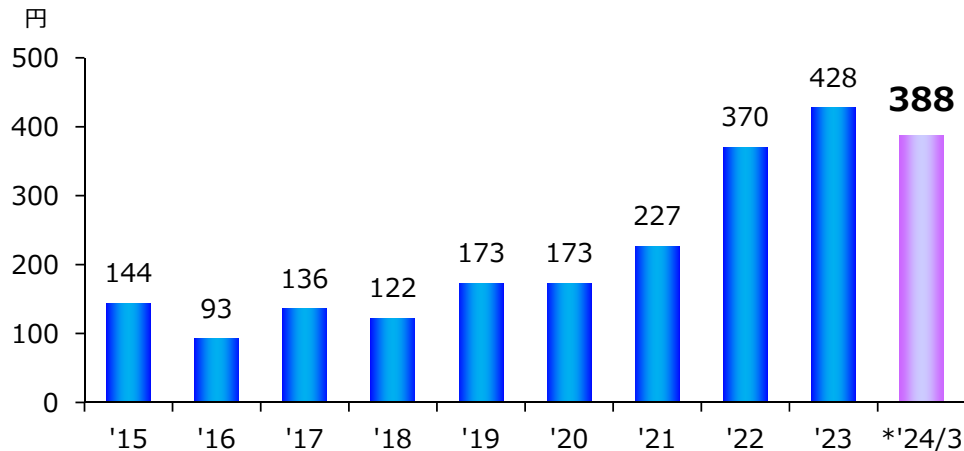
分割実施

	2021/3月期		2022/3月期		2023/3月期		2024/3月期	
	予想* 2020/11/4	実績 2021/5/12	期初予想 2021/5/12	実績 2022/5/31	期初予想 2022/5/31	実績 2023/5/10	期初予想 3分割前	期初予想 3分割後
中間配当金	50円	50円	60円	85円	95円	110円	110.01円	36.67円
期末配当金	50円	65円	65円	100円	105円	110円	110.01円	36.67円
年間配当金	100円	115円	125円	185円	200円	220円	220.02円	73.34円
配当性向	47.5%	50.7%	49.8%	49.9%	49.4%	51.4%	56.7%	56.7%

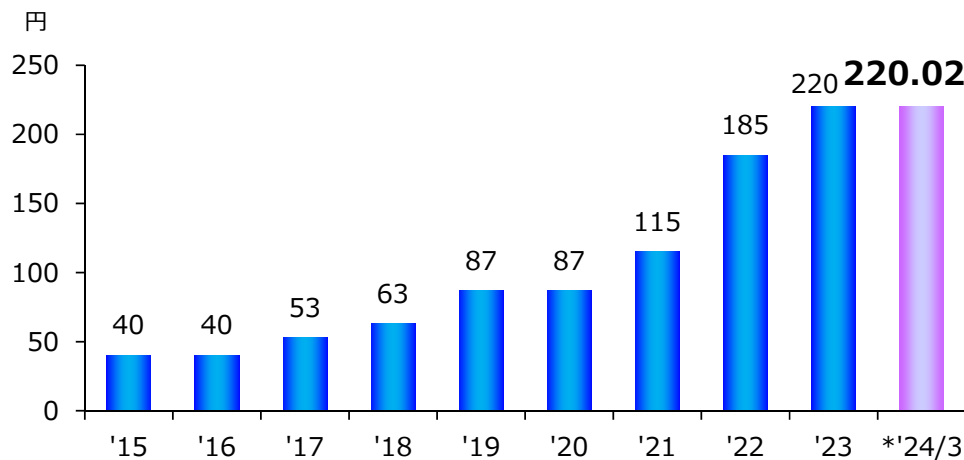
*2021/3月期の期初予想はコロナ影響により未定とした。

積極的な株主還元と安定配当の継続（分割前基準）

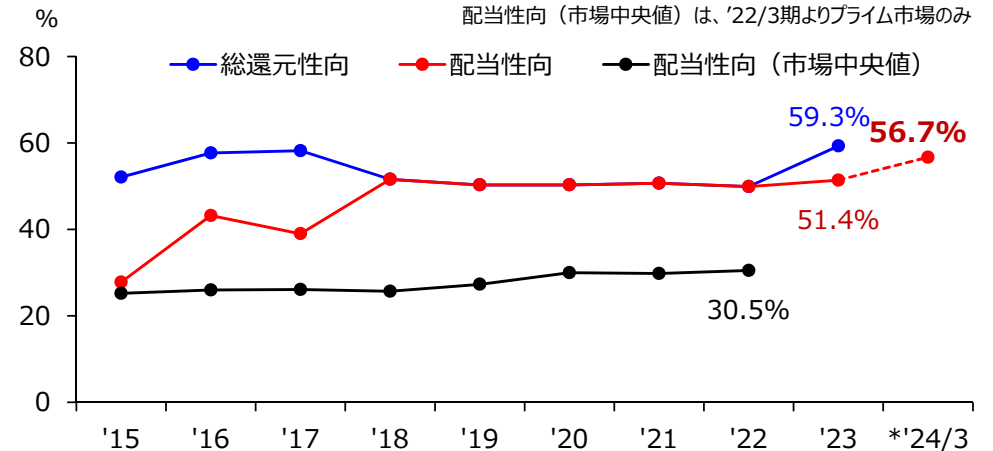
1株当たり当期純利益（分割前基準）



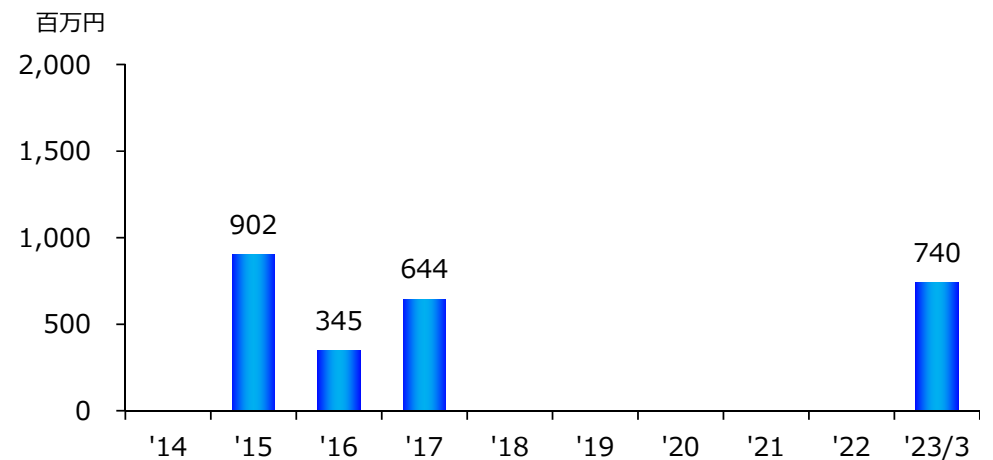
1株当たり配当金（分割前基準）



総還元性向・配当性向



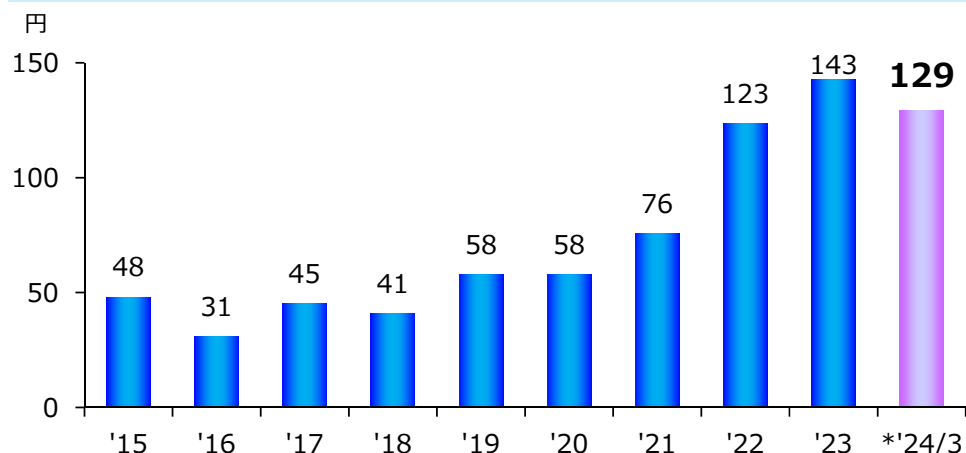
自己株買い



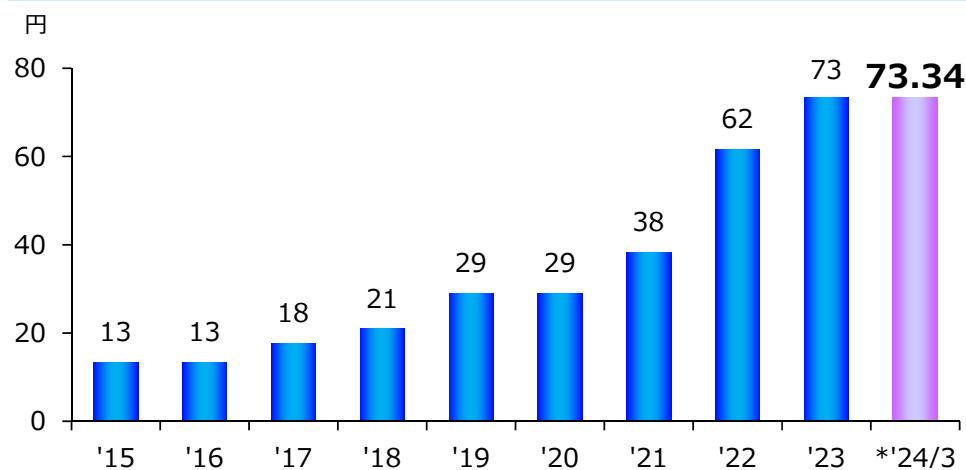
*'24/3は計画

積極的な株主還元と安定配当の継続（分割後基準）

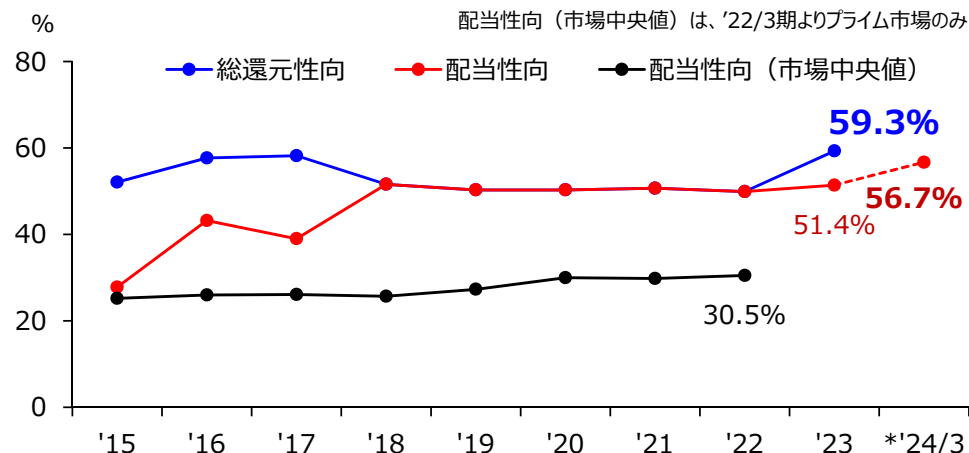
1株当たり当期純利益（分割後基準）



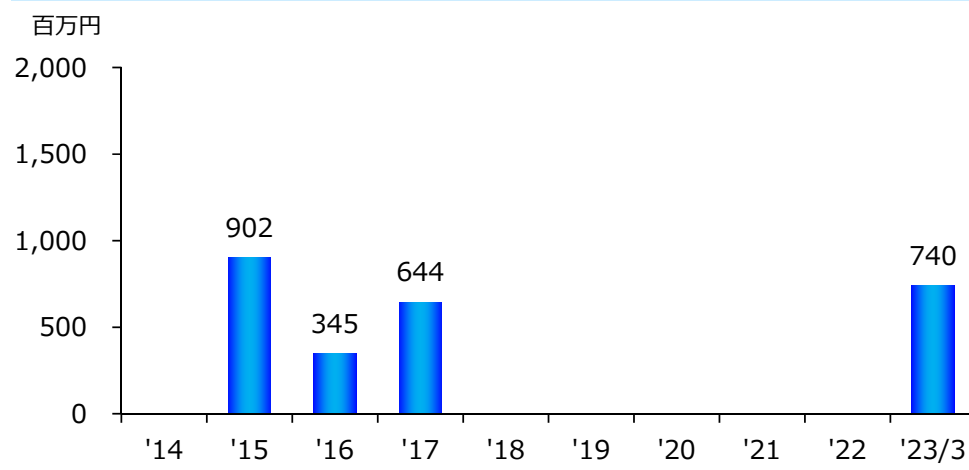
1株当たり配当金（分割後基準）



総還元性向・配当性向



自己株買い



*'24/3は計画

2023年3月期 業績サマリー／2024年3月期 業績予想

【2023年3月期 業績サマリー】 *前期比

✓ 売上高	+12.9%*	: 上期の堅調な半導体需要に加え、原材料高騰に伴う製品値上げや為替の影響もあり、 2期連続過去最高を更新 但し、下期は半導体市場調整により大幅減速
✓ 営業利益	+9.8%	:
✓ 経常利益	+8.8%	:
✓ 当期純利益	+15.7%	: 営業利益、経常利益は4期、当期純利益は5期連続過去最高を更新
✓ シリコンウェハー向け	+12.9%	: シリコンウェハーの高稼働によりラッピング・ポリシングは増収
✓ CMP向け	+16.7%	: 上期の堅調な半導体需要及び為替の影響により増収
✓ ハードディスク向け	△12.7%	: 第3四半期におけるHDD市場の急激な調整を受け減収
✓ 一般工業用向け	+6.5%	: 自動車及び産業機械向け需要の回復もあり増収
✓ 株主還元		: 前年比35円増配（19%増）の一株当たり年間配当金220円

【2024年3月期 業績予想】

✓ 売上高	+0.2%	: 上期には半導体市場の調整が続くも、下期の需要回復を想定し売上高横ばい
✓ 営業利益	△5.6%	: 売上高横ばいも原材料価格高騰・減価償却費増により減益を見込む
✓ 経常利益	△6.6%	:
✓ 当期純利益	△9.4%	:

技術を磨き、心をつなぐ

FUJIMI

FUJIMI INCORPORATED